

【Al,AlN,Cu対応フォトリソケミカル】 PK-DEXシリーズ

特長

- ◆アルミ、窒化アルミ、銅にも適用可
アルミ、窒化アルミ、銅に対して極めて低エッチングレート
- ◆低発泡性
シャワー現像装置においても発泡トラブルなく使用可能
- ◆引火性なく、非危険物

Al,AlN,Cu Etching

	Etching rate (nm/min.)		
	Al	AlN	Cu
TMAH(2.38%)	36.0	>100	0.1
PK-DEX4000	2.1	N/A	0.0
PK-DEX4050	<1	1	0.0

【Applicable】

製品名	推奨温度	推奨濃度	特長
PK-DEX4000	23℃～25℃	原液	スタンダードタイプ
PK-DEX4310	23℃～25℃	30%	水希釈タイプ
PK-DEX4020	23℃～25℃	原液	リフトオフレジストにも適用可
PK-DEX4050	23℃～25℃	原液	窒化アルミにも適用可

現像液

- ◆インヒビターの表面保護作用によりアルミ、窒化アルミ、銅との反応を抑制し、TMAH2.38%では困難であったアルミ、窒化アルミ、銅などが付いた基板の現像が可能。また、リフトオフレジストにも適用可能。



洗浄液

- ◆特殊界面活性剤の浸透、湿潤作用で残渣の隙間に入り込み、有機アルカリの溶解作用を促進させ除去する。特にドライエッチング残渣の除去性に有効。

